

证券代码：600877

证券简称：电科芯片

公告编号：2026-025

中电科芯片技术股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3306号），中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）187,110,185.00股，发行价格为4.81元/股，募集资金总额人民币899,999,989.85元。

2021年12月16日，公司收到特定投资者实际缴纳的募集资金人民币899,999,989.85元，本次发行累计发生发行费用人民币24,864,697.19元（不含增值税），其中承销费及财务顾问费18,867,924.53元（不含增值税）、其他发行费用5,996,772.66元（不含增值税）。扣除不含增值税的发行费用后募集资金净额为人民币875,135,292.66元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字〔2021〕第1-10045号）。

（二）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2021年向特定对象非公开发行股票
募集资金到账时间	2021年12月16日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日

项 目	金 额
一、募集资金总额	90,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	2,486.47
二、募集资金净额	87,513.53
减：	63,268.87
以前年度已使用金额	47,180.14
2026 年 1-6 月使用金额	4,489.56
以前年度永久补充流动资金	11,585.45
2026 年 1-6 月永久补充流动资金	
暂时补流金额	
以前年度银行手续费支出及汇兑损益	1.74
2026 年 1-6 月银行手续费支出及汇兑损益	-0.01
应收保证金	11.99
加：	1,791.10
以前年度募集资金利息收入	1,785.96
2026 年 1-6 月募集资金利息收入	5.14
三、报告期期末募集资金专户余额	26,035.76

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中电科芯片技术股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于2021年12月27日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各

方的权利和义务；公司募投项目实施主体子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司（以下简称西南设计）、重庆中科芯亿达电子有限公司（以下简称芯亿达）、深圳市瑞晶实业有限公司（以下简称瑞晶实业）并连同公司、中国国际金融股份有限公司于2021年12月27日分别与招商银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

前述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称		2021 年向特定对象非公开发行股票		
募集资金到账时间		2021 年 12 月 16 日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
中电科芯片技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010078801500005031	0.03	使用中
重庆西南集成电路设计有限责任公司	招商银行股份有限公司重庆分行	023900205710808	13,281.21	使用中
重庆中科芯亿达电子有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	999008000310111	2,393.21	使用中
深圳市瑞晶实业有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	755900874010809	10,361.31	使用中
合 计			26,035.76	

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司高性能无线通信及新能源智能管理集成电路研发及产业化建设项目和高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目，募集资金主要用于研发投入、设备购置等，旨在增强公司研发能力，项目本身不能单独核算经济效益，但通过提升技术水平和创新能力，间接促进公司整体业务发展和竞争力提升。

公司智能电源集成电路应用产业园建设项目，募集资金主要投入厂房购置，对原有生产线的产能扩充，生产流程涉及原有设备和新增设备，无法直接单独核算其经济效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026 年 1-6 月公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

金额单位：人民币万元

发行名称		2021 年向特定对象非公开发行股票			
募集资金到账时间		2021 年 12 月 16 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
12,000.00	2025 年 4 月 23 日	12 个月	2025 年 4 月 23 日	2026 年 4 月 13 日	12,000.00

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026 年 1-6 月公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目已建设完成，公司第十三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目结

项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意芯亿达募投项目结项并将节余的募集资金 2,393.21 万元（含累计利息收入扣除手续费后净额 13.37 万元，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于补充流动资金，待公司股东会审议通过后实施，目前节余资金存放于芯亿达募集资金账户。

（八）募集资金使用的其他情况

2026 年 1-6 月公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目，募集资金主要用于研发投入、设备购置等，旨在增强公司研发能力，项目本身不能单独核算经济效益，但通过提升技术水平和创新能力，间接促进公司整体业务发展和竞争力提升。

公司智能电源集成电路应用产业园建设项目，募集资金主要投入厂房购置，对原有生产线的产能扩充，生产流程涉及原有设备和新增设备，无法直接单独核算其经济效益。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2026 年 1-6 月，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年 1-6 月，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2026 年 1-6 月

编制单位：中电科芯片技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称					2021 年向特定对象非公开发行股票								
募集资金到账日期					2021 年 12 月 16 日								
募集资金总额					90,000.00								
2026 年 1-6 月投入募集资金总额					4,489.56								
已累计投入募集资金总额					63,255.14								
变更用途的募集资金总额					不适用								
变更用途的募集资金总额比例					不适用								
承诺投资项目投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	2026 年 1-6 月投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%） (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2026 年 1-6 月实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高性能无线通信及新能源智能管理集成电路研发及产业化建设项目	生产项目/研发项目	否	33,656.38	33,656.38	33,656.38	4,356.46	20,453.01	-13,203.37	60.77	2026 年 12 月	建设中	不适用	否

高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目	生产项目/研发项目	否	12,084.79	12,084.79	12,084.79	123.38	9,704.95	-2,379.84	80.31	2026 年 6 月	建设完	不适用	否
智能电源集成电路应用产业园建设项目	生产项目	否	31,837.00	31,837.00	31,837.00	9.72	21,511.73	-10,325.27	67.57	2026 年 12 月	建设中	不适用	否
永久性补充流动资金	补流		12,421.83	9,935.36 [注 1]	9,935.36	—	11,585.45	1,650.09[注 2]	116.61				
合 计	—	—	90,000.00	87,513.53	87,513.53	4,489.56	63,255.14	-24,258.39	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）						高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目涉及的部分产品因市场环境、需求、应用方案变化，导致产品技术指标升级、研发周期延长，项目实施进度晚于预期，详见《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-044）。 智能电源集成电路应用产业园建设项目因实施地点变更、投资金额调整等因素影响，导致项目实施进度晚于预期，详见《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的公告》（公告编号：2023-017）、《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-038）、《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-032）。							
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						公司于 2022 年 1 月 18 日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 1,087.48 万元。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已经发表明确同意意见。本次置换已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《中电科声光电科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字〔2022〕第 1-00080 号，详见公司于 2022 年 1 月 19 日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》）。公司已于 2022 年 1 月 26 日用募集资金置换先期投入自筹资金 1,087.48 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十三届董事会第五次会议、第十三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司西南设计拟使用不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，西南设计已于 2026 年 4 月 13 日归还 12,000 万元。							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司使用不超过人民币 63,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品（结构性存款），于 2023 年 1 月 16 日归还。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	公司于 2026 年 6 月 29 日召开第十三届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意子公司芯亿达募投项目结项并将结余募集资金 2,393.21 万元用于永久补充流动资金（具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）。存在结余的主要原因为：第一，项目实施过程中，芯亿达通过不断改进工艺、优化设计方案等，使得实际投资额有所降低；第二，项目实施过程中，芯亿达从项目的实际情况出发，本着节约、合理、有效的原则，科学使用资金，严格把控项目各个环节，合理地降低项目建设成本；募投项目中部分研发项目获得政府补助支持，从而进一步节省募集资金支出并形成结余。
募集资金其他使用情况	不适用

[注1]补充流动资金承诺投资总额与调整后投资总额的差额2,486.47万元，系发行费用金额，详见2021年12月23日披露的《中电科声光电科技股份有限公司验资报告》（大信验字（2021）第1-10045号）。

[注2]补充流动资金截至期末累计投入金额高于调整后投资总额主要系银行存款利息及投资理财收益。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2026 年 1-6 月

编制单位：中电科芯片技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称			2021 年向特定对象非公开发行股票												
募集资金到账日期			2021 年 12 月 16 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	2026 年 1-6 月实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	2026 年 1-6 月实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目	高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目	生产项目 / 研发项目	芯亿达	重庆	12,084.79	12,084.79	123.38	9,704.95	80.31	2026 年 6 月	建设完	不适用	否	2024 年 10 月 28 日	不适用
智能电源集成电路应用产业园建设项目	智能电源集成电路应用产业园建设项目	生产项目	瑞晶实业	深圳	31,837.00	31,837.00	9.72	21,511.73	67.57	2026 年 12 月	建设中	不适用	否	2025 年 10 月 30 日	不适用
合 计					43,921.79	43,921.79	133.10	31,216.68	-	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)			1.由于募投项目涉及的部分产品因市场环境、需求、应用方案变化，导致产品技术指标升级、研发周期延长，项目实施进度晚于预期。公司第十三届董事会第二次会议、第十三届监事会第二次会议审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》（详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》），同意将“高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目”达到预定可使用状态日期从 2024 年 12 月调整为 2026 年 6 月。 2. 由于募投项目实施地点及投资金额调整等因素影响，导致项目实施进度晚于预期。公司第十二届董事会第十五次会议、第十二届监事会第十二次会议、												

	2022 年年度股东大会审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的议案》，同意将“智能电源集成电路应用产业园建设项目”实施地点调整为广东省深圳市龙岗区宝龙街道新能源二路宝龙专精特新产业园，投资总额调整为 32,434.00 万元，其中预计募集资金投资金额 31,837.00 万元（详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的公告》）；公司第十二届董事会第十八次会议、第十二届监事会第十五次会议审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》，同意将“智能电源集成电路应用产业园建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 12 月（详见公司于 2023 年 12 月 15 日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》）；公司第十三届董事会审计与风险控制委员会第七次会议、第十三届董事会独立董事专门会议第四次会议、第十三届董事会第七次会议审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》，同意将“智能电源集成电路应用产业园建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月（详见公司于 2025 年 10 月 31 日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	1. 高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目涉及的部分产品因市场环境、需求、应用方案变化，导致产品技术指标升级、研发周期延长，项目实施进度晚于预期，该项目已于 2026 年 6 月完工。 2. 智能电源集成电路应用产业园建设项目实施地点变更和投资金额调整，受厂房、配套建筑的实际建设、装修计划和设备安装、调试安排影响，项目实施进度晚于预期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用